



2020年4月15日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 山 村 章
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
問 合 わ せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年7月1日付で、当社の連結子会社である株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ（以下、「フェローテックマテリアルテクノロジーズ」といいます。）を存続会社、同じく当社の連結子会社である株式会社フェローテック（以下、「フェローテック」といいます。）を消滅会社とする吸収合併を行なうことを決議しましたので下記の通りお知らせします。

記

1. 合併の目的

フェローテックマテリアルテクノロジーズは、セラミックスや CVD-SiC^{※1}等の半導体等製造装置関連セグメント製品の製造、販売を行っております。また、フェローテックは、磁性流体、サーモジュール等の電子デバイスセグメント製品に加え、真空シール、石英、パワー半導体用板(DCB)等の半導体等製造装置関連セグメント製品の販売^{※2}を行っており、両社は、当社グループの中核を担う事業を各々行っております。

本合併により、顧客ニーズへの対応力および新材料、新製品の開発力の強化を図っていくとともに、車載関連等半導体以外への市場開拓、管理機能の統合による効率化を積極的に進めながらグループ内シナジーの実現と業容拡大を目指してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 日程

取締役会決議日	2020年4月15日
合併契約締結日	2020年4月15日
合併期日（効力発生日）	2020年7月1日（予定）

(2) 合併方式

本合併は、フェローテックマテリアルテクノロジーズを存続会社、フェローテックを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当ての内容

100%子会社間の合併のため株式等の割当てはありません。

^{※1} CVD法（Chemical Vapor Deposition）を用いた炭化ケイ素（SiC）であり、特長として、超高純度・高耐食性・高耐酸化性・高耐熱性・高耐摩耗性に優れているため、半導体素子製造工程で用いられるウェハポートやチューブ、シリコンウェハの代替となるダミーウェハなど、主に高温で使用される治具に使われています。

^{※2} 真空シール、磁性流体については、同社千葉工場にて製造も行っております。

3. 合併当事者の概要（2020年4月15日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ	株式会社フェローテック
(2) 所在地	東京都中央区日本橋2-3-4	東京都中央区日本橋2-3-4
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松田 泰明	代表取締役社長 松田 泰明
(4) 事業内容	セラミックス製品、CVD-SiC 製品の製造、販売等	磁性流体および応用製品、半導体製造装置および同部品、電子機器部品の製造、販売等
(5) 資本金	485,500 千円	350,000 千円
(6) 決算期	12月	3月
(7) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%

4. 合併後の状況（予定）

(1) 名称	株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ
(2) 所在地	東京都中央区日本橋2-3-4
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松田 泰明
(4) 事業内容	セラミックス製品、CVD-SiC 製品、磁性流体および応用製品、半導体製造装置および同部品、電子機器部品の製造、販売等
(5) 資本金	485,500 千円
(6) 決算期	12月
(7) 大株主及び持株比率	当社 100%

5. 今後の見通し

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上